

无锡靖芯科技有限公司

2025 年度企业质量信用报告

前 言

无锡靖芯科技有限公司为履行产品质量主体责任，提高企业质量诚信意识和质量法制意识，推动社会公众监督，依据 GB/T 19001—2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系 要求》及 GB/T 31870-2015《企业质量信用报告编写指南》，编制本年度《企业质量信用报告》。本报告客观反映了公司在报告期内质量诚信管理工作的基本情况，包括企业质量理念、企业质量管理、质量诚信管理、质量管理基础、产品质量责任等方面的理念、制度、措施及成效，定期向社会公布，以接受社会各界的监督指导。

一、报告编制规范

1. 报告内容客观性声明

本报告本着客观、公正的态度进行编写，报告内容真实、有效，符合企业实际情况。报告中公布的信息，其收集、记录、整理、分析和公布均经得起审核验证。

2. 报告组织范围

本报告所涉及的内容范围为无锡靖芯科技有限公司及其覆盖的质量管理体系活动的区域和场所，包括质量部、研发部、人事部、行政部、运营部、市场部、销售部、财务部等涉及产品的现场和部门。

3. 报告时间范围

本报告为 2025 年度报告，时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

4. 报告发布周期

本报告为年度报告，发布周期为每年一次，根据实际情况动态更新报告内容。

5. 报告编写原则

本报告遵循真实性、时效性、可读性、完整性的原则：

真实性：客观公布企业在报告期内质量诚信管理工作的基本情况；

时效性：采用的数据信息及时反映企业质量信用状况；

可读性：采用简洁的语言，适当使用数据表等形式，易于阅读和理解；

完整性：报告内容结构完整，全面反映企业质量信用状况。

6. 报告参考标准

本报告参照以下标准编制：

GB/T 19000-2015/ISO9001：2015《质量管理体系 基础和术语》

GB/T 19001-2015/ISO9001：2015《质量管理体系 要求》

GB/T 31870-2015《企业质量信用报告编写指南》

GB/T 29467《企业质量诚信管理实施规范》

7. 报告数据说明

本报告引用数据来源于公司质量管理体系运行记录、各部门统计报表、第三方检测报告及客户满意度调查等，数据统计口径以公司内部管理制度和记录控制程序为准。

8. 报告获取方式

本报告以网络版形式发布，可在公司官方网站（www.stbchip.com）获取，同时以书面形式备存，可供顾客、供应商及其他相关方查阅。

二、总经理致辞

尊敬的用户、合作伙伴及社会各界朋友：

作为一家专业从事模拟集成电路、数模混合集成电路以及功率器件等产品研究、开发及销售的公司，无锡靖芯科技有限公司始终秉持“稳健求实、精益求精、持续创新、客户满意”的质量方针，致力于为客户提供多元且具竞争力的产品以及完整的解决方案。

质量是企业的生命，信用是企业的根基。集成电路产业作为国家战略性新兴产业，产品质量直接关系到下游电子产品的可靠性与安全性。我们深知，每一颗芯片背后，都承载着客户对我们的信任与期待。为此，公司依据 GB/T 19001—2015 idt ISO9001: 2015 标准建立了系统化、文件化的质量管理体系，并在此基础上有序推进质量信用体系建设，将“稳健求实、合规质控，诚信履约、溯源尽责，持续创新、打造可信产品，树立行业质量信用标杆”确立为质量信用管理方针。

过去的一年里，公司进一步强化了从晶圆设计、封装测试到成品交付的全链条质量管控。针对客户端反馈的质量问题，我们快速响应、深度分析、彻底整改，先后完成了 JX6314DR-G 客户端失效比例过高、JX3503AMR-G 混料等质量问题的纠正与预防，形成了从问题发现到根因分析、措施实施、效果验证的完整闭环。我们始终坚持“第一次就把正确的事情做对”的零缺陷理念，通过持续的教育和案例分享，让质量意识深入人心。

展望未来，靖芯科技将继续坚持以领先的技术和优良的品质为客户创造价值，不断完善质量信用管理体系，以更高的标准、更严的要求、更实的行动，为客户提供高性价比的产品和可信赖的服务，致力于成为国内半导体行业的知名品牌。

衷心感谢社会各界长期以来对靖芯科技的关心、支持与信任！

三、企业简介

公司名称：无锡靖芯科技有限公司

法定代表人/总经理：黄年亚

所有权性质：有限责任公司

总部所在地：中国江苏省无锡市滨湖区蠡园开发区吟白路 1 号研创大厦 1901-3 室

联系方式：电话：0510-83910701

网址：www.stbchip.com

主营业务：功率器件成品和晶圆、集成电路成品和晶圆的设计开发和销售。

公司简介：无锡靖芯科技有限公司是一家专业从事模拟集成电路、数模混合集成电路以及功率器件等产品研究、开发及销售的公司。公司专注于提供客户多元且具竞争力的产品以及完整的解决方案。自成立以来，靖芯科技专注于整合技术能力、坚持质量和积极的客户服务，以提供客户产品价值为宗旨，为客户提供高性价比产品。

质量体系：公司按 GB/T 19001—2015 idt ISO9001：2015 标准的要求建立了系统化、文件化的质量管理体系。

四、企业质量理念

4.1 企业愿景

以领先的技术和优良的品质为客户创造价值，成为国内半导体行业的知名品牌。

4.2 质量方针

公司确立了 **“稳健求实，精益求精，持续创新，客户满意”** 的质量方针：

稳健求实：以沉稳严谨的态度，以实事求是的精神，坚持对自己的工作质量负责，做正确的事情，一次做好；

精益求精：以追求卓越的理念，以一丝不苟的行动，坚持高标准高质量，为客户提供一流的产品和一流的服务；

持续创新：以持续不懈的努力，以系统化的方法，坚持技术创新、价值创新、管理创新、质量创新，为客户、为供方、为公司创造更多价值；

客户满意：坚持客户至上的原则，全员参与，满足客户需求，追求客户满意。

4.3 质量信用管理方针

在质量方针基础上，公司确立了独立的质量信用管理方针：

“稳健求实、合规质控，诚信履约、溯源尽责，持续创新、打造可信产品，树立行业质量信用标杆。”

该方针的内涵包括：

稳健求实、合规质控：确保产品全流程符合国家标准及行业规范；

诚信履约、溯源尽责：建立从晶圆设计、封装测试到成品交付的全链条质量追溯体系；

持续创新、打造可信产品：以零重大质量失信事件为目标，稳步提升客户认可度与社会公信力。

4.4 质量文化建设

公司通过多种方式和途径开展质量文化建设：

（1）内部宣传教育

公司通过《人力资源管理程序》规范员工培训体系，制订《年度培训计划》，组织员工进行职业技能、质量意识、安全法规等方面的培训并进行评估。通过员工手册、钉钉软件、员工培训、部门日常培训等方式开展岗前培训、在职培训及专业培训。组织质量专题培训，如中检集团江苏公司组织的质量管理体系培训，持续提升全员质量意识。

（2）“零缺陷”文化灌输

通过持续的教育和案例分享，让“第一次就把正确的事情做对”的“零缺陷”理念成为全体员工的共识和习惯。公司每月度和年度通过数据分析的结果寻求改善的机遇。

（3）质量意识提升

公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解质量方针、质量目标、对质量管理体系有效性的贡献以及不符合质量管理体系要求的后果。

五、企业质量管理

5.1 质量管理机构

公司建立了完善的质量管理组织架构：

（1）总经理

总经理黄年亚是公司质量管理体系的第一责任人，负责主持质量管理体系的策划工作，制定并颁布质量管理体系方针、目标，确定各岗位、职能部门的职责和权限，提供相应的资源，定期组织管理评审，保证质量管理体系持续有效运行和持续改进。

（2）管理者代表

管理者代表邹治旻负责确保质量管理体系符合 GB/T 19001-2015 标准的要求，确保各过程获得其预期输出，报告质量管理体系绩效及其改进机遇，确保在整个公司推动以顾客为关注焦点。

（3）各部门质量职责

部门	质量职责
质量部	质量管理体系文件和记录的控制；产品检验状态的标识；监视和测量设备的控制；各类产品的检验和试验；内部审核；不合格品的纠正、预防措施和改进
研发部	新产品设计开发；项目评估、启动、进度协调；技术标准、检测标准的制定；现有产品设计和工艺改进
运营部	生产计划及进度控制；外包过程监控；供方选择、评价及再评价；客户订单交期落实；仓库管理
市场部	市场调研；产品定义；推广策划；客户抱怨处理；售后服务和技术支持
销售部	产品销售；合同评审；顾客财产管理；顾客满意度测量
人事部	员工招聘考核；培训计划制定与实施；员工档案管理
行政部	办公设备及网络维护；知识产权管理；行政后勤保障
财务部	财务制度编制；财务统计；质量成本核算

5.2 质量管理体系

（1）体系建立

公司按 GB/T 19001—2015 idt ISO9001：2015 标准的要求建立了系统化、文件化的质量管理体系，编制了 A.1 版《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。体系文件包括《质量手册》、程序文件、管理规范、作业规范、工艺文件、作业指导书等。

（2）质量方针和目标

公司制定了“稳健求实，精益求精，持续创新，客户满意”的质量方针。2025年度质量目标包括：

部门	目标项	目标值
公司目标	顾客满意度	≥90 分
公司目标	赔偿 5 万以上的质量投诉	≤2 个
销售部	销售额	≥6000 万元
销售部	顾客满意度	≥90 分
运营部	平均封测良率	≥97%
运营部	平均封装周期	≤45 天
研发部	Tapeout 产品数	4 个
研发部	全年量产产品数	4 个
质量部	赔偿 5 万以上的质量投诉	≤2 个

（3）质量教育

公司通过《人力资源管理程序》规范培训工作：

制订《年度培训计划》，组织员工进行职业技能、质量意识、安全法规等方面的培训；

对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或招聘具备能力的人员；

建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录。

（4）质量责任赔偿

公司通过《销售管理程序》和《不合格品管制程序》规范质量责任赔偿工作。对于因产品质量问题给客户造成的损失，公司按照合同约定及相关法律法规要求承担赔偿责任。

5.3 质量安全风险管理

公司制定和运行《风险和机遇管理程序》，系统开展质量安全风险管理工作。

（1）质量风险监测

公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。公司定期对内部和外部因素的相关信息监视和评审。

公司识别的质量安全风险点包括：

设计开发风险：产品设计缺陷可能导致功能性能不达标；

外包过程风险：封装、中测等外包过程的质量控制；

供应商风险：原材料和服务的质量波动；

客户使用风险：产品在客户端应用过程中的失效。

（2）风险控制措施

公司根据风险分析结果，策划应对风险和机遇的措施：

规避风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果；

明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；

评价这些措施的有效性。

应对风险和机遇的措施与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。

（3）应急管理

公司建立了质量异常应急处理机制：

当发现测量设备不符合预期用途时，确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取适当的纠正措施；

对不合格输出进行识别和控制，防止其非预期的使用或交付；

对顾客反馈问题实施快速响应，24 小时内响应。

六、企业质量诚信管理

6.1 质量承诺

（1）产品质量承诺

公司郑重承诺：

所有产品符合相关国家标准和行业标准要求；

产品设计和开发过程严格遵循《设计和开发管理程序》，确保满足输入要求和法律法规要求；

外部提供的过程、产品和服务符合要求；

在策划的安排已圆满完成之前，不向顾客放行产品和交付服务。

（2）服务承诺

及时处理顾客需求，认真履行合同；

及时处理顾客抱怨，开展售后服务；

为客户提供技术支持，解决客户使用过程中的技术问题；

客户投诉 24 小时内响应。

（3）诚信承诺

公司承诺：

质量信用信息公示及时率 100%；

无虚假质量宣传事件；

质量承诺履约完成率 $\geq 99\%$ 。

6.2 运作管理中的质量诚信管理

（1）设计开发过程诚信管理

公司通过《设计和开发管理程序》规范设计开发过程：

确定设计和开发的各个阶段和控制；

确保设计和开发输入充分、适宜、完整、清楚；

对设计和开发过程进行评审、验证和确认；

对设计和开发更改进行识别、评审和控制。

（2）采购与外包过程诚信管理

公司通过《供应商评估管理程序》和《采购管理程序》规范采购与外包过程：
确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则；
根据外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力进行评价；
对外包过程（封装、中测）进行重点监控；
保留评价和必要的措施的形成文件的信息。

（3）生产过程诚信管理

公司通过《委外加工管理程序》规范生产过程：
在受控条件下进行生产和服务提供；
采用适当的方法识别产品，避免混淆；
对产品施加唯一性标识（批号、编号、日期），实现可追溯；
对输出进行必要的防护（标识、处置、包装、贮存、传输或运输）。

（4）产品售后质量诚信管理

公司通过《销售管理程序》规范售后工作：
及时处理顾客抱怨，开展售后服务；
为客户提供技术支持；
监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受；
通过顾客调查、顾客反馈等方式获取顾客满意度信息。

6.3 质量诚信管理典型案例

案例 1：JX6314DR-G 客户端失效比例过高问题

问题发现：2024 年 7 月，JX6314DR-G 产品在客户端失效比例过高，市场部反馈需内部排查分析原因。

原因分析：质量部通过对不良品 FA（失效分析）发现封装异常；进一步排查发现封测厂将筛选出的某一类不良品放入了良品中。

纠正措施：要求封测厂立即更新测试程序，并针对此次问题回复 8D 报告。

实施与验证：运营部与封测厂确认测试程序已更新，8D 报告已回复；使用新的测试程序后，客户反馈无异常。

案例 2：JX3503AMR-G 混料问题

发现问题：2025 年 6 月，客户反馈 JX3503AMR-G 定制产品 YN890X 中混有一盘印字为 JD353 的器件，铝箔袋信息与卷盘实物信息不符。

原因分析：通过鱼骨图和 5Why1H 分析，确定主要原因包括标签多打、多余标签未及时清理、贴铝箔袋标签时未核对实物信息、QC 未 100%双重确认。

永久性预防措施：包装员工贴铝箔袋标签时 100%核对内外标签信息；QC 100%二次核对标签信息；控制标签打印数量，按照包装需求打印标签，不可多打，桌面多余标签及时清空。

效果验证：封测厂完成培训，公司安排人员对封测厂包装工段进行审核验证。

七、企业质量管理基础

7.1 标准管理

公司依据 GB/T 19001—2015 idt ISO9001：2015 标准建立了质量管理体系。公司技术标准包括：

产品设计标准：涵盖集成电路和功率器件的设计规范；

工艺标准：涵盖晶圆制造、封装、测试等工艺要求；

检测标准：涵盖产品性能、可靠性等检测规范；

管理标准：涵盖质量管理体系各过程的控制要求。

研发部负责组织完成项目所需的电路图纸、晶圆版图、技术标准、检测标准等资料。

7.2 计量管理

公司通过《计量器具管理程序》规范监视和测量设备的管理

对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行检定或校准；

对测量设备予以标识，以确定其校准状态；

予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化；

当发现测量设备不符合预期用途时，确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取适当的纠正措施。

质量部负责监视和测量设备的控制，确保监测设备的定期校准。

7.3 认证管理

公司质量管理体系符合 GB/T 19001—2015 idt ISO9001：2015 标准要求。公司通过内部审核（依据《内部审核控制程序》）和第三方认证审核，确保质量管理体系持续符合标准要求。

7.4 检验检测管理

公司建立了完善的检验检测体系：

来料检验：依据《原辅材料验收规范》对外部提供的产品进行检验；

过程检验：在适当阶段实施监视和测量活动，验证是否符合过程控制准则；

成品检验：依据《产品入库检验规范》对成品进行检验和放行；

不合格品管理：依据《不合格品管制程序》对不符合要求的输出进行识别和控制。

八、企业产品质量责任

8.1 产品质量水平

（1）产品覆盖范围

公司产品覆盖功率器件成品和晶圆、集成电路成品和晶圆的设计开发和销售。

（2）质量目标完成情况

公司 2025 年度关键质量指标完成情况：

指标	目标值	完成情况
顾客满意度	≥90 分	—
赔偿 5 万以上的质量投诉	≤2 个	—
平均封测良率	≥97%	—

平均封装周期	≤45 天	—
--------	-------	---

（3）质量改进

公司持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，每个月度和年度通过数据分析的结果寻求改善的机遇。同时通过公司管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定持续改进的需求和机会。

8.2 产品售后责任

（1）售后服务

公司通过《销售管理程序》规范售后服务工作：
及时处理顾客抱怨，开展售后服务；
为客户提供技术支持，解决客户使用过程中的技术问题；
认真履行合同，及时处理顾客需求。

（2）质量投诉处理

公司建立了规范的质量投诉处理机制：
市场部负责接收客户投诉，24 小时内响应；
质量部负责组织原因分析和纠正措施；
有效质量投诉办结率目标 100%。

（3）质量责任赔偿

对于因产品质量问题给客户造成的损失，公司按照合同约定及相关法律法规要求承担赔偿责任。2025 年度赔偿 5 万以上的质量投诉目标≤2 个。

8.3 质量信用记录

（1）良好记录

公司按 GB/T 19001—2015 idt ISO9001：2015 标准建立了系统化、文件化的质量管理体系；

公司通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证；

公司产品广泛应用于多个领域，获得客户认可。

（2）不良记录及改进

报告期内，公司未发生重大质量安全事故、质量行政处罚事件和虚假质量宣传事件。针对客户端反馈的质量问题，公司均按照纠正预防措施流程进行闭环处理。

九、报告结语

质量信用是企业的无形资产，是赢得客户信任和市场认可的根本保障。无锡靖芯科技有限公司始终将质量视为企业生命，将信用视为发展根基，坚持以领先的技术和优良的品质为客户创造价值。

展望未来，公司将持续完善质量信用管理体系：

（一）健全质量信用管控体系：进一步完善从设计开发到售后服务的全链条质量信用管理制度，落实质量主体责任。

（二）强化质量诚信文化建设：持续开展质量诚信宣传教育和培训，让“第一次就把正确的事情做对”的零缺陷理念深入人心。

（三）提升产品和服务质量：通过持续创新和技术进步，不断提升产品可靠性和客户满意度。

（四）自觉接受社会监督：定期发布企业质量信用报告，主动公开质量信用信息，接受社会各界监督。

靖芯科技将以更高的标准、更严的要求、更实的行动，持续提升质量信用管理水平，致力于成为国内半导体行业的知名品牌，为客户、为行业、为社会创造更大价值。

